**苏州国芯科技股份有限公司**

**2025年9月12日投资者关系活动记录表**

**证券简称：国芯科技 证券代码：688262 编号：2025-022**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 √业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称** | 线上参与公司2025半年度业绩说明会的全体投资者 |
| **时间** | 2025年9月12日13：00 |
| **地点** | 上证路演中心 <https://roadshow.sseinfo.com> |
| **上市公司参加人员姓名** | 董事长：郑茳  董事、总经理：肖佐楠  董事会秘书：龚小刚  财务总监：张海滨  独立董事：权小锋 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 2025年9月12日13:00至14:00，公司在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了2025半年度业绩说明会。公司董事长郑茳先生首先致词，向广大投资者报告了公司2025半年度经营情况。随后，公司管理层与投资者进行了线上交流。主要内容如下：  **1、公司强调推动AI与量子技术与现有产品融合。请问在汽车电子（如高端域控芯片CCFC3009PT）和量子安全芯片（如抗量子密码卡）方面，目前有哪些具体的研发突破、客户导入或量产计划？**  答：尊敬的投资者，您好！公司车载高性能RISC-V AI MCU 芯片产品 CCFC3009PT采用 RISC-V 架构 6+6 核设计，内置 NPU 子系统，支持虚拟化技术，集成网络节点硬件路由模块，创新存储器与安全设计，该芯片已完成设计，即将进行流片验证。公司积极发展量子安全技术和产品，重点围绕量子安全芯片和模组、抗量子安全芯片和模组进行研发和产业化应用，目前已基于量子随机数发生器开发了多款量子安全芯片、终端应用量子安全模组、服务器和云应用量子安全模组，在智能终端、电力系统、电子政务、视频监控等多个领域有着广泛的应用前景。公司的量子安全相关产品已实现对外供货，向国内量子信息安全领域的多家厂商开展产品销售，包括中电信量子、问天量子和合肥硅臻等。公司与参股公司信大壹密成功研发的抗量子密码芯片AHC001是基于国产28nm工艺制程，并采用国芯科技CPU内核设计的一款可重构低功耗抗量子密码算法芯片。该芯片可以同时支持传统密码算法和抗量子密码算法应用，内部集成了抗量子密码算法引擎、ECC引擎以及对称密码处理器。抗量子密码算法引擎采用可重构电路技术实现，具备低功耗、算法可重构、高安全性以及高扩展性特点，可用于多种应用领域产品的高安全防护，适用于今后对安全要求较高的各种端和边缘侧设备场合，可以广泛应用于金融、通信、电力、物联网等有高安全要求的信息安全设备中，可作为公钥基础设施（PublicKey Infrastructure，PKI）参与数字安全基础设施建设，助力保障新时代数字经济发展。目前，公司正在和合作方基于该款抗量子密码芯片积极结合特定领域的信息安全密码保护升级需要进行产品和方案开发。作为国内领先的信创和信息安全芯片及模组研发企业，公司始终致力于研发并丰富公司的量子安全产品线。谢谢！  **2、公司上半年亏损略有扩大，三费占比上升明显。在研发高投入（营收占比89.9%）的战略下，公司将通过哪些具体措施（如优化人员结构、库存管理等）来控制运营成本，以期尽快实现盈利？**  答：尊敬的投资者，您好！2025年，公司存货管理工作持续深化。在库存盘点核查方面，公司扩充库房面积、优化库存空间布局，提高盘点效率。在盘盈盘亏分析方面，公司基于统计数据进行数据挖掘和分析，优化细化成本核算，确保各类存货成本的准确计量，为公司成本控制与定价策略提供可靠依据。为优化库存管理，公司从销售端获取订单开始，便会结合库存情况、生产周期以及市场需求预测，对生产进行准确计划。对于长账龄库存商品，公司根据实际市场情况制定有针对性的销售策略，提高产品的销售速度，提升存货周转率。同时，公司从多方面积极推进降本增效工作的落实，严格控制成本和支出，努力提升产品的毛利率。谢谢！  **3、公司汽车电子芯片收入同比增长63.81%，累计出货超1700万颗。面对国际竞争，公司如何进一步提升中高端MCU、DSP芯片的市占率？以及“MCU+套片”方案的具体推广进展和预期贡献如何？**  答：尊敬的投资者，您好！在汽车电子芯片领域，公司继续坚持“顶天立地”和“铺天盖地”的发展战略，公司将在现有市场和客户基础上依托技术优势，发挥自主 MCU、混合信号驱动芯片、通信接口芯片与传感器芯片的套片优势，为客户提供完善且具成本竞争力的整体解决方案，进一步扩大市场占有率。例如：（1）公司推出了声学DSP芯片系列CCD5001/CCD4001/CCD3001，该系列芯片采用12nm先进工艺技术设计和生产，已有多家客户在实际开发应用中。该产品可广泛用于汽车音频放大器、音响主机、主动降噪ANC/RNC、后座娱乐和数字驾驶舱等。（2）公司已成为国内最先同时拥有汽车安全气囊主控芯片、点火芯片和加速度传感器芯片的芯片厂商，基本实现汽车安全气囊芯片组的国产化替代，将为国内车企在安全气囊供应链安全提供重要支持。作为国内首颗获得TÜV北德ISO 26262 ASIL-D 功能安全产品认证的安全气囊点火驱动芯片，CCL1600B芯片在2025年7月初中标4600万元，已在多家整车厂实现装车应用和批量出货，并有多家客户完成了DV/PV实验，公司的MCU芯片在安全气囊控制器产品已实现稳定批量应用，在安全气囊控制器单点装车应用中超过300万颗，充分证明了其卓越的安全性和可靠性。广汽集团与国芯科技联合开发的气囊点火芯片正在推进上车应用。同时，公司与包括国际安全气囊头部企业在内的多家合作伙伴积极推进安全气囊芯片的创新与应用，已取得较为显著的进展。谢谢！  **4、2025年上半年，公司研发的重要新产品有哪些？这些新产品目前应用的进展怎么样？**  答：尊重的投资者，您好！2025年上半年，公司先后推出的重要新产品包括超高性能云安全芯片CCP917T、抗量子密码芯片AHC001、抗量子密码卡CCUPHPQ01、汽车电子安全气囊点火芯片CCL1800B，实现了公司在云安全、抗量子密码和汽车电子领域的新突破。其中，超高性能云安全芯片CCP917T的SM2签名效率达到100万次/s，对称算法性能达到80Gbps，达到行业先进水平，满足国家三级及以上等保要求，具有广泛的应用前景。这些重要的芯片目前均已向客户送样，客户正在进行应用开发工作，目前各项工作进展顺利。谢谢！  **5、公司RAID芯片进展如何，今明两年能否批量化应用并贡献收入？**  答：尊敬的投资者，您好！公司RAID存储控制芯片和模组产品已实现实际市场的应用销售，一方面，公司自主研发的CCRD3304芯片已成功导入移动通信基站、信创服务器等多个项目中；另一方面，某头部视频监控设备厂商成功导入CCUSR6104 RAID卡。除此之外，某国家重大需求项目已经选型公司CCUSR8116 RAID卡。谢谢！  **6、公司AI业务的布局与进展情况怎么样？**  答：尊敬的投资者，您好！公司的AI业务包含定制AI芯片业务和自主AI芯片业务。公司定制AI芯片业务目前在手订单充足，上半年由于受外部因素影响生产周期加长，导致影响交付和收入的形成，截至2025年8月27日，定制AI业务的供应链已改善，正在积极组织相关芯片生产和交付等工作。公司自主AI芯片业务目前包括AI MCU芯片、AI云安全芯片等，均基于RISC-V CPU技术进行研发。公司AI MCU芯片CCR4001S目前已在家电的主动感知与节能控制、婴儿看护的隐私友好监护、工业检测、光伏拉弧检测以及电机控制等场景落地验证，并与生态伙伴联合推出AI传感器模组，帮助客户加速量产导入、降低系统成本、缩短开发周期。公司车载高性能RISC-V AI MCU 芯片产品 CCFC3009PT采用 RISC-V 架构 6+6 核设计，内置 NPU 子系统，支持虚拟化技术，集成网络节点硬件路由模块，创新存储器与安全设计，该芯片已完成设计，即将进行流片验证。公司超高性能AI云安全芯片CCP917T的SM2签名效率达到100万次/s，对称算法性能达到80Gbps，内置NPU子系统，达到行业先进水平，满足国家三级及以上等保要求，具有广泛的应用前景。此外，公司正在基于参股公司江原科技国产自主AI算力芯片和公司自有CCT02 TCM可信芯片开发可信AI推理卡，该可信AI推理卡支持国密SM2/3/4算法，支持静态启动度量功能，防止客户在使用软件的过程中可能会遭遇破坏或者黑客的恶意攻击，保护敏感信息不被窃取或不被恶意代码使用，可以满足《GM/T 0012-2020可信计算》标准。同时公司积极布局AI NPU技术研发。在NPU领域，公司和香港应科院、龙擎视芯等单位合作面向端/边缘侧应用开展AI技术研发，开发CNN20、CNN100、CNN200和CNN300系列化NPU IP核，其中CNN20和CNN100已完成设计验证并可以对外授权，CNN200和CNN300正在研发中。面向AI PC应用，公司和参股公司龙擎视芯正在合作开发CNN300 NPU IP核， CNN300以标量运算单元和矢量运算矩阵相结合，利用专用重构化可编程技术，形成通用可编程形式的人工智能加速体，单核性能将可达8TOPS，CNN300具有多核一致性接口MLS，支持多个CNN300 IP核之间扩展实现更高算力，保障单任务多核情况下数据流的同步和统一，如利用四核堆叠将实现32TOPS算力；MLS接口也支持多颗集成CNN300 IP核的SoC芯片之间进行数据一致性同步，使得SoC芯片能够利用chiplet机制实现多核多芯片算力堆叠效果。CNN300将支持INT8/FP8/FP16等常规AI应用所需要的数据类型，支持传统的CNN、RNN应用，也能支持最新流行的LLM（大语言模型）应用；相比于传统ASIC形式NPU加速器，CNN300具有灵活可重构和高性能高带宽低功耗特点。未来公司将积极拥抱AI技术，根据应用需求大胆创新，特别是在交叉领域的集成创新上，将AI技术研究成果积极应用到公司现有的汽车电子和工业控制芯片产品、信创和信息安全芯片产品上，持续提升公司汽车电子和工业控制芯片产品、信创和信息安全芯片产品的智能化水平，进一步提高公司产品的核心竞争力。谢谢！  **7、公司研发的RISC-V指令架构CPU内核目前的进展情况怎么样？**  答：尊敬的投资者，您好！自2017年以来，公司一直在致力于研发具有自主知识产权的高性能低功耗RISC-V架构的嵌入式CPU技术，公司成功研发了CRV0、CRV4/CRV4E/CRV4H/CRV4L、CRV5、CRV7系列RISC-V CPU IP核，并且都有国产化软件开发工具链支持。其中：CRV4E在CRV4的基础上针对电机控制应用扩展了DSP指令；CRV4H是符合功能安全要求的处理器，该处理器性能可对标ARM公司的Cortex-M4版本。另外，公司还基于RISC-V指令架构开展神经网络扩展指令集架构研究，在RISC-V处理器上运行扩展自定义指令，形成神经网络处理器专用指令集，能够支持神经网络算法的加速处理，并用于CRV4AI和CRV7AI处理器的实现。与国际公司合作开发适用于汽车电子高端域控支持虚拟化应用的CRV6 CPU IP核；与赛昉科技合作，公司完成CRV9 CPU IP核引进合作以及与北京开芯院合作，完成CRV9H IP核引进合作，可满足高性能计算的应用需要。谢谢！  **8、在汽车电子数模混合领域公司的业务布局和发展策略是怎么样的？**  答：尊敬的投资者，您好！在汽车电子数模混合领域，公司集成化混合信号设计平台趋于成熟，已成功研发安全气囊点火芯片、PSI5通信芯片、加速度计传感器芯片、门区驱动芯片、线控底盘电磁阀驱动芯片、BLDC芯片，配合公司系列汽车电子MCU，形成较强性价比的“MCU+”混合信号套片解决方案，增强了汽车电子芯片产品市场竞争力，随着汽车电子进一步向高压化、智能化发展，混合信号芯片将成为连接模拟世界与数字系统的关键纽带，其技术创新将深度影响整车能效、功能安全与用户体验，公司尝试构建48V混合信号芯片设计平台，CCL1800B是公司面向48V架构成功研发的首款安全气囊点火芯片，实现业界首发，作为48V安全气囊点火芯片填补了这一领域的空白，以该芯片为基础，公司搭建48V混合信号芯片设计平台，平台化布局初步成型并支撑后续多应用领域扩展，公司将持续加强在汽车电子数模混合信号领域的耕耘。谢谢！  **9、公司为什么要研发48V汽车电子芯片产品，目前进展怎么样？**  答：尊敬的投资者，您好！随着新能源汽车智能化进程加快，传统12V低压系统已难以满足新一代智能功能的功率需求。48V系统以其更高的功率承载、更优的能效表现和更强的功能安全保障，成为汽车电气架构升级的关键路径。公司积极应对这一发展趋势，尝试构建48V混合信号芯片设计平台，CCL1800B是公司面向48V架构成功研发的首款安全气囊点火芯片，实现业界首发，作为48V安全气囊点火芯片填补了这一领域的空白，实现了新能源汽车安全气囊点火应用电子电气系统架构领域的创新与突破。以该芯片为基础，公司搭建48V混合信号芯片设计平台，平台化布局初步成型并支撑后续多应用领域扩展。谢谢！ |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2025年9月 |